

广东世运电路科技股份有限公司
关于拟投资建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）或控股子公司拟投资建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目（以下简称“芯创智载”项目）
- **投资金额：**人民币 15.00 亿元
- **审批情况：**本次投资事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次拟投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。
- **风险提示：**本次投资项目是公司基于未来发展战略，经筹划论证所做出的谨慎决定，项目投产运营后可能面临受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，可能造成投资项目不达预期效益的风险。本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。项目预计在 2025 年下半年动工建设，2026 年中开始投产，对公司 2025 年经营业绩不会造成重大影响。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

随着近年人工智能及新能源汽车技术的高速发展，PCB 作为电子产业的一种核心基础组件，对 PCB 供应商的生产工艺以及供应链联合创新能力提出了更高的要求，包括具有高密度及多层设计、高性能材料、精细制造工艺、优质的信号传输及散热等特性。公司于 2022 年获广东省发展和改革委员会批准成立“新一代电动汽车高端芯片互连载板创新平台”，依托该平台着力发展“芯片内嵌式 PCB 封装技术”，即采用嵌埋工艺将功率芯片直接嵌入到 PCB 板内，通过创新的制程工艺实现器件与 PCB 的一体化，优化芯片与电路板的信号传输路径与散热性能，提高系统功效和可靠性，在新能源汽车、数据中心、高功率通信设备、人形机器人、储能、航空航天等领域具有广阔的应用前景。目前该项目已经取得显著成果，芯片内嵌式 PCB 产品已经通过一系列静态、动态测试达成性能设计和信赖性要求，并陆续获得终端主机厂客户项目定点。

为推进芯片内嵌式 PCB 产品规模化生产以及进一步提升公司高阶 HDI 产品的产能，公司计划在鹤山总部周边地块建设“芯创智载”项目，项目预计总投资约 15.00 亿元人民币，主要产品为芯片内嵌式 PCB 产品和高阶 HDI 电路板产品，设计产能为 66 万平方米/年。

（二）审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于拟投资建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次拟投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目

（二）项目实施主体：公司或控股子公司

（三）项目实施地点：鹤山市共和镇铁岗工业区

（四）项目投资概算：项目总投资额为人民币 15.00 亿元，具体将根据实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准

（五）项目建设内容：本项目总投资额为 15.00 亿元，其中建筑工程费 4.63 亿元，设备购置及安装费 9.62 亿元，铺底流动资金 0.6 亿元。项目通过引进国内外先进的印制电路板生产设备及配套设施，招聘高素质的技术、管理和生产人员，旨在提升公司高端电路板的量产能力，满足下游客户对 PCB 不断提升的工艺要求，以及增强公司的核心竞争力。

（六）项目产品类型及产能：芯片内嵌式 PCB 产品 18 万平方米/年，高阶 HDI 电路板产品 48 万平方米/年。

（七）项目建设周期：18 个月，计划于 2025 年下半年开工建设，2026 年中开始投产。

（八）资金来源：自有或自筹资金

（九）项目进展及审批、备案情况：项目尚处于筹备阶段，尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

三、本次投资的背景、必要性及可行性

（一）本次投资的背景和必要性

根据 Prismark 预计，2025 年 HDI 和 18 层以上多层板将分别增长 12.9%和 41.7%，从中长期来看，18 层以上高多层板和 HDI 受到人工智能相关产业的驱动，2024 年-2029 年复合增长率将分别达 15.7%和 6.4%，高于 PCB 行业整体约 5.2% 平均增速。其中，芯片内嵌式 PCB 产品是 PCB 未来的发展方向之一。芯片内嵌带来三大核心优势：（1）消除键合线，减小机械应力失效，显著提升芯片互连技术的可靠性；（2）通过消除键合线并采用超短连接路径，电感可降至 1nH 以下，进一步会降低开关损耗和电压过冲，大幅改善电气性能；（3）通过内嵌的方式，不仅减少了封装体占用的空间、降低了封装成本，还一定程度提升了电气性能和散热效果。通过功率芯片 PCB 封装化实现模组高能耗比、高密度轻量化和高可靠性

人工智能、新能源汽车等重点下游领域增速较快，带动高端 PCB 需求和价值

增长。首先，从市场需求角度，公司 HDI 业务近两年需求增长强劲，特别是人工智能、汽车电子、医疗电子等领域订单显著增加，而当前公司现有的 HDI 产能不足，制约了公司在这些高增长领域的业务拓展。其次，从公司战略布局来看，推进芯片内嵌式 PCB 产品规模化生产以及进一步提升公司高阶 HDI 产品的产能有助于公司优化产品结构，提升在高端 PCB 领域的竞争力，符合公司向高附加值产品领域转型的长期战略目标。通过扩大高端产品产能，公司能够进一步提升规模效应，降低单位生产成本，提高产品的市场竞争力，增强公司的盈利能力与抗风险能力。综上，公司计划因应市场需求变化，放缓公司定增募投项目的建设进度，将资源优先集中推动建设“芯创智载”项目。

（二）本次投资的可行性

凭借多年在 PCB 研发、生产经验，公司拥有 PCB 制造领域多项核心技术，并高效地转化为产品竞争力的提升。公司目前已经掌握本项目的核心技术“芯片内嵌式 PCB 封装技术”，相关产品已经通过一系列静态、动态测试达成性能设计和信赖性要求，并获得部分主流汽车终端主机厂和 OEM 的认可。

此外，经过多年发展，公司凭借先进的技术、高质量的产品和专业的服务，已与国内外众多知名品牌商建立了长期稳定的合作关系，积累大量优质稳定的客户资源，广泛分布于人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI 智能眼镜等新兴领域。

四、本次投资对上市公司的影响

公司拟投资建设“芯创智载”项目，旨在提升公司高端电路板的量产能力，满足下游客户对 PCB 不断提升的工艺要求，以及增强公司的核心竞争力。芯片内嵌式 PCB 产品目前主要应用在新能源汽车动力域，通过更高的集成度和功率密度，显著提升了电气性能，包括降低系统杂感及开关损耗，大幅提升开关速度，从而达到提升续航里程的效果。目前芯片内嵌式 PCB 产品已获得部分主流汽车终端主机厂和 OEM 的认可，产品需求市场日益扩大。本项目具备良好的预期经济效益，建成后将为公司增加新的利润增长点，提升企业品牌影响力，与公司的长远规划和高质量发展战略要求相契合。该项目的建设不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

本次对外投资的资金全部来源于公司或控股子公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时，本次拟新设的控股子公司将纳入公司合并报表，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）市场竞争风险

随着国内 PCB 同业在新能源汽车、数据中心/服务器、通信设备 PCB 等领域的布局，后续市场竞争可能存在愈发激烈的风险，进而影响行业整体的盈利能力。虽然目前行业领先企业具有较为明显的综合竞争优势，在客户、规模、研发、技术、质量、成本控制等多个方面均处于优势地位。但由于国内从事 PCB 生产的企业较多，且部分企业成长较快，竞争力日益增强。随着市场的扩大，竞争对手也将加大对产品研究开发和市场开拓力度，导致竞争加剧，项目可能面临客户及订单数量不及预期的风险。公司将加大研发投入，提升技术能力，开发高附加值的新产品，调整产品结构，提升高端产品占比，积极开拓新的订单稳定的客户，以此提高公司抗风险能力。

（二）项目建设、产能爬坡不达预期风险

本项目在实施过程中，可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、设备价格和原材料价格波动等问题，导致项目建设周期延长、实际投资额超出预算，实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。公司将成立项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调，严格控制项目进度和成本管理，确保项目按计划推进。

（三）项目管理运营风险

高端 PCB 产品技术含量高，若公司在技术研发、工艺创新方面未能持续投入或未能准确把握行业技术发展趋势，可能导致新增产能的技术水平未能跟上市场需求变化，产品竞争力下降。新产品在量产过程中可能面临良率不稳定、产能利用率不高等问题，影响项目盈利能力。公司将继续强化研发优势，保证产品符合客户需求、适应行业发展趋势，并将通过科学的管理手段继续提高产品质量的稳定性，以良好的质量推动市场份额的提升。

（四）项目投资资金风险

本项目总投资约 15 亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金，若未来公司经营活动现金流不及预期或外部融资环境发生不利变化，可能面临一定的资金筹措压力。截至 2025 年 6 月 30 日，公司营业收入 25.79 亿元，货币资金 14.93 亿元，交易性金融资产 28.26 亿元，总资产 88.81 亿元，资产负债率 25.20%。公司资信情况良好，银行授信额度充足，没有对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求，与供应商充分协商更友好的付款方式，根据需要科学规划融资方案，优化资本结构，合理控制融资成本和财务风险，确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

（五）项目审批风险

本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可和影响投资计划顺利实施的风险。公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日